

全国半导体设备和材料标准化 技术委员会材料分技术委员会

半材标委[2023]31号

关于召开 2023 年度全国半导体设备和材料标准化技术委员会 材料分技术委员会年会的通知

各位委员、各会员单位及相关单位：

为全面贯彻党的二十大精神，深化中共中央、国务院《国家标准化发展纲要》，落实《2023 年国家标准化工作要点》《碳达峰碳中和标准体系建设指南》《新产业标准化领航工程实施方案（2023-2035 年）》等文件要求，进一步强化标准化工作在行业发展中的作用。根据国家市场监督管理总局、工业和信息化部以及中国有色金属工业协会下达的有关标准制修订计划的文件精神和标委会工作需要，现定于 2023 年 11 月 13 日~11 月 16 日在浙江省丽水市召开 2023 年度全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会年会，请全体委员务必出席会议，同时请各会员单位、各起草单位及相关单位派代表参会。现将会议有关事宜通知如下：

一、会议日程和会议内容

- 11 月 13 日，全天报到。
- 11 月 14 日，上午 8:30~12:00 举行全体大会，会议内容如下：
 - 领导讲话。
 - 全国半导体材料标准化分技术委员会秘书处作 2023 年度工作报告。

③ 表彰 2023 年度全国半导体材料分标委会“特殊贡献奖”、“技术标准优秀奖”和“先进工作者”。

④ 行业技术交流及研讨。

3、11 月 14 日，下午 13:30~18:00 继续全体大会，会议内容如下：

① 终审 2023 年度审定完成的标准项目。

② 论证 2024 年度半导体材料标准计划项目。请所有项目提出单位按照《关于征集 2023 年度全国半导体材料标准化分技术委员会年会论证的标准计划项目的通知》（半材标委[2023]25 号）的要求，提前准备相关论证材料。秘书处将于年会前汇总所有需要论证的新计划项目，会议期间原则上不再接收新项目建议。

4、11 月 15 日，上午 8:30 开始分组会议，会议内容如下：

对《埋层硅外延片》等 12 项半导体材料国家、行业 and 团体标准进行审定、预审和讨论（具体项目见附件）。请各标准负责起草单位于 11 月 6 日前将相关标准稿件发送至秘书处邮箱(tc203sc2@cnsmq.com)，由秘书处挂网征求意见。各相关单位可于 11 月 10 日之后在有色标准信息网(www.cnsmq.com)“标准制定工作站”栏目下载会议资料。

5、11 月 16 日早餐后返程。

二、报到时间、地点及乘车路线

1、报到时间：2023 年 11 月 13 日。

2、报到地点：丽水宝廷酒店（浙江省丽水市莲都区花园路 388 号，0578-2279999）。

3、乘车路线：①丽水站：乘坐 3 路公交到南明旅游学校站下车，步行 400 米到达酒店；乘出租车到酒店约 4 公里，约 13 元。②义乌机场：乘坐义乌 380 路公交到北站小区（何界）站，换乘义乌 805 路公交到火车站下车，步行 40 米到义乌火车站，乘坐相应班次高铁到达丽水站，然后乘坐 3 路公交到南明旅游学校站下车，步行 400 米到达酒店；乘出租车到酒店约 160 公里，约 500 元。

三、会议协办与会务工作

本次会议由有色金属技术经济研究院有限责任公司、全国半导体材料标准化分技术委员会和浙江省丽水市人民政府共同主办，丽水经济技术开发区管委会和 FerroTec（中国）集团承办，杭州盾源聚芯半导体科技有限公司和杭州中欣晶圆半导体股份有限公司协办。

会议期间，食宿统一安排，宿费自理。

标委会秘书处：李素青 010-62565659 15652368697。

会议会务组：18709316115（会议会务）、010-62257692（缴费、发票）。

四、会议报名及缴费

请参会代表务必于 2023 年 11 月 6 日前登录会议报名系统（<http://www.ysmeeting.net>）注册、完善个人信息、住房需求及单位发票信息。本次会议收取会议费 900 元/人。为有效保障会议用房安排和会议资料的准备，11 月 6 日之后及现场缴费收取 1200 元/人。汇款请注明：11 月半材年会（个人汇款请备注单位名称）。汇款账户信息如下：

收款单位：有色金属技术经济研究院有限责任公司

开户行：中国光大银行北京中关村支行

账号：0875 0812 0100 3010 18526

附件：审定、预审和讨论的标准项目

抄报：全国半导体设备和材料标准化技术委员会



附件：

讨论的标准项目

序号	计划文号及编号	项目名称	主编单位	备注
第一组				
1	国标委发[2022]17号 20220133-T-469	埋层硅外延片	南京国盛电子有限公司	审定
2	国标委发[2021]19号 20211956-T-469	半导体晶片表面金属沾污的测定 全反射 X 射线荧光光谱法	有研半导体硅材料股份公司	审定
3	工信厅科(2023)18号 2023-0001T-YS	集成电路用四甲基硅烷	洛阳中硅高科技有限公司	讨论
4	工信厅科(2023)18号 2023-0082T-YS	半导体材料掺杂用扩散膜	安徽安芯电子科技股份有限公司	讨论
5	正在公示 (2023000386)	半导体晶片直径测试方法	麦斯克电子材料股份有限公司	讨论
第二组				
6	工信厅科函[2022]94号 2022-0109T-YS	硅材料中氢含量的测定 惰性气体熔融热导法	江苏中能硅业科技发展有限公司	审定
7	中色协科字[2022]100号 2022-060-T/CNIA	多晶硅行业清洁生产评价指标体系	四川永祥股份有限公司	审定
8	工信厅科函[2022]94号 2022-0250T-YS	颗粒硅总金属杂质含量的测定 电感耦合等离子体质谱法	江苏中能硅业科技发展有限公司	预审
9	工信厅科函[2022]94号 2022-0470T-YS	多晶硅生产用石墨制品表面杂质含量的测定 电感耦合等离子体光谱法	新疆协鑫新能源材料科技有限公司	预审
10	工信厅科函[2022]312号 2022-2014T-YS	再生硅料	隆基绿能科技股份有限公司	预审
11	工信厅科(2023)18号 2023-0083T-YS	区熔用多晶硅材料	陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司	讨论
12	正在公示 (2023000379)	太阳能级多晶硅	洛阳中硅高科技有限公司	讨论